



Ref. Certif. No.

JPTUV-054786

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE****CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product
Produit

LCD MONITOR

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurTPV Electronics (Fujian) Co., Ltd.
Shangzheng, Yuan Hong Road
Fuqing City, Fujian Province, P.R. ChinaName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantTPV Electronics (Fujian) Co., Ltd.
Shangzheng, Yuan Hong Road
Fuqing City, Fujian Province, P.R. ChinaName and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

See additional page(s)

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

AC 100-240V; 50/60Hz; 1.5A; Class I

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

AG neovo

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

N/A

Model / Type Ref.
Ref. de type

TM-22, TM-23

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

For model differences, refer to the test report.

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à laIEC 60950-1:2005+A1
National differences see test reportAs shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

17027153 004

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification**TÜVRheinland**®TÜV Rheinland Japan Ltd.
Global Technology Assessment Center
4-25-2 Kita-Yamata, Tsuzuki-ku
Yokohama 224-0021 Japan
Phone + 81 45 914-3888
Fax + 81 45 914-3354
Mail: info@jpn.tuv.com
Web: www.tuv.com

Date: 15.01.2014

Signature:

Ing. M. Eichenseder